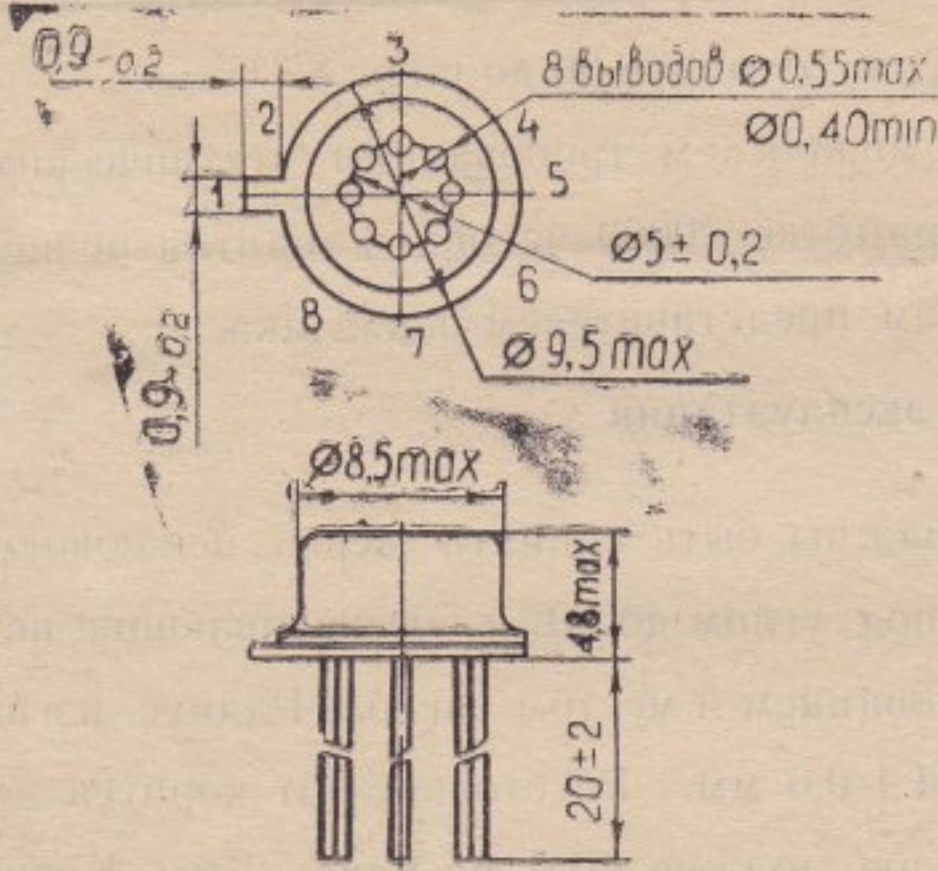




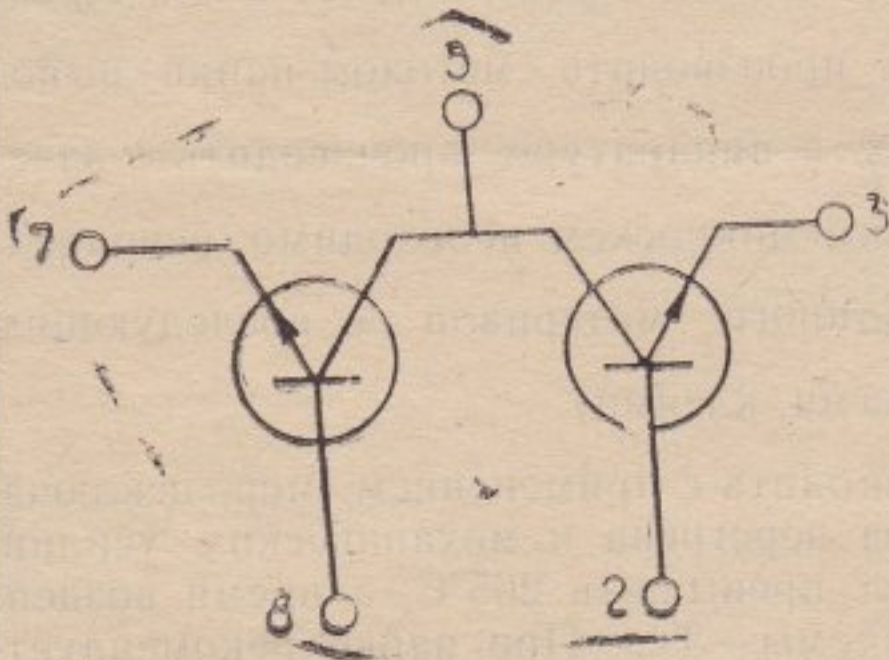
П А С П О Р Т

Микросхемы интегральные типов: ИКТО11А, ИКТО11Б, ИКТО11В, ИКТО11Г

Соответствуют частным техническим условиям 3.365.003 ТУ
Функциональное назначение — интегральный прерыватель



| №№ выводов | Наименование |
|------------|--------------|
| 1 | — |
| 2 | База 1 |
| 3 | Эмиттер 1 |
| 4 | — |
| 5 | Коллектор |
| 6 | — |
| 7 | Эмиттер 2 |
| 8 | База 2 |



Содержание драгметаллов в 1000 шт. изделий: золото 28, 23 г.
Вес не более 1,5 г.

Основные электрические параметры при температуре плюс $20 \pm 5^\circ\text{C}$

| Наименование параметров | Обозначение | Ед. измерения | Нормы | | | | Режим измерения |
|--|-----------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | ИКТО11А | ИКТО11Б | ИКТО11В | ИКТО11Г | |
| Остаточное напряжение между эмиттерами при $I_{\text{Э}1\text{Э}2} = 0$ не более | U_0 | мкВ | 50 | 150 | 50 | 150 | $I_{\text{Б}1} + I_{\text{Б}2} = 2\text{мА}$ |
| Ток утечки между эмиттерами при $U_{\text{КБ}1} = U_{\text{КБ}2} = 0$ не более | $I_{\text{Э}1\text{Э}2\text{ут}}$ | нА | 10 | 10 | — | — | $U_{\text{Э}1\text{Э}2} = \pm 63\text{В}$ |
| | | | — | — | 10 | 10 | $U_{\text{Э}1\text{Э}2} = \pm 3\text{В}$ |
| Сопротивление между эмиттерами | r_0 | Ом | 100 | 100 | 100 | 100 | $I_{\text{Б}1} + I_{\text{Б}2} = 2\text{мА}$ $I_{\text{Э}1\text{Э}2} = 100\text{мкА}$ |

Предельно-допустимые обратные напряжения

| Наименование параметров | Н о р м ы | | | |
|-------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1КТО11А | 1КТО11Б | 1КТО11В | 1КТО11Г |
| Напряжение коллектор-база (В) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Напряжение эмиттер-база (В) | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 |

Диапазон рабочей температуры от минус 60 до плюс 85°C.

Гарантируется соответствие микросхем требованиям технических условий в течение 12 лет при наработке 10000 часов. Гарантия исчисляется со дня приемки микросхем представителем заказчика.

Указания по эксплуатации

При монтаже микросхем должны быть приняты меры, исключающие изгиб выводов более 3 раз под углом до 90° и обеспечивающие неподвижность вывода между основанием и местом изгиба. Радиус изгиба вывода должен быть равен $1 \pm 0,5$ мм. Расстояние от корпуса до центра окружности изгиба выводов должно быть не менее 2 мм. Крепление микросхем к печатной плате производить методом пайки выводов. Установку микросхем на плату в аппаратуре производить с зазором не более 3,5 мм. При установке микросхем необходимо использовать прокладки из электроизоляционного материала с последующим дополнительным креплением (лаками, клеями).

Пайку выводов следует производить с применением мер, исключающих повреждение микросхем из-за перегрева и механических усилий. При пайке температура не должна превышать 265°C, а время воздействия этой температуры на микросхемы—3 с. При пайке рекомендуется применять припой ПОС-61 (ГОСТ 1499—70) и флюс ФКСп по ИО 054.063. Не допускается применение микросхем в предельно-допустимых режимах. Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин «питание» и «земля») к выводам микросхем, не используемым согласно принципиальной электрической схеме.

При ремонте аппаратуры замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания. После монтажа микросхемы должны быть защищены лаками (например, УР-231 или ЭП100). Количество слоев—2÷3.

Август 1975г.

Дата изготовления

Штамп представителя
заказчика



Штамп ОТК

